

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

Session	No.	Title	Author	Affiliation
1. 전자패키징 소재/장비/공정 기술	P1-01	Oxidation-free bonding of Ag nanoporous sheets to bare Cu substrates for enhanced EMC molding	조은진	한국생산기술연구원
	P1-02	Driving forces of oxidation-free cold copper sinter bonding in the air	김예리	한국생산기술연구원
	P1-03	비전도성 접착제와 Ni-Less 표면처리를 적용한 미세피치 플립칩 인터커넥션 기술의 최적화 연구	이태영	한국공학대학교
	P1-04	전기방사를 활용한 고방열 EMC용 첨가 소재의 개발	추연룡	국립한밭대학교
	P1-05	EMC 폐기물의 재활용을 통한 균일한 실리카의 제조 및 CMP Slurry 응용	제갈석	국립한밭대학교
	P1-06	포토리소스트 공정에서 발생할 수 있는 슬러지의 인자 확인 및 형성 방지법의 제안	김찬교	국립한밭대학교
	P1-07	반도체 제조 공정에서 발생하는 실리콘을 함유한 슬러지를 재활용한 자율주행차량용 검은색 소재의 제조	김지원	국립한밭대학교
	P1-08	레이저 기반 상온 접합 공정 및 레이저 비전도성 페이스트를 적용한 인듐 솔더 접합부의 신뢰성 분석	정지은	한국전지통신연구원
	P1-09	레이저 기반 상온 접합 공정으로 형성된 솔더 조인트의 신뢰성 전/후 미세구조 분석	이기은	한국전지통신연구원
	P1-10	리플로우 에너지원 변화에 따른 솔더 접합부 특성	이효원	충북대학교
	P1-11	CMP 공정 대체를 위한 RDL의 평탄화 방법	강민지	서울과학기술대학교
	P1-12	Soldering on Reliability of BGA Package with SAC 305/SACBI Solder joint	성민재	성균관대학교
	P1-13	미세 피치 적용을 위한 type 7 수용성 솔더 페이스트 개발 및 특성 평가	최동규	한국생산기술연구원
	P1-14	LAB (Laser-Assisted Bonding) 및 Type 8 솔더 페이스트를 이용한 접합의 기계적 특성	구준호	서울시립대학교
	P1-15	Adhesive-free bonding of flexible substrates by using laser heating	이은혜	한국생산기술연구원
	P1-16	Soldering Temperature Control using Photonic Energy by Light Absorption Differences	노태준	성균관대학교
	P1-17	Cu 결정립 크기 및 방향 변화에 따른 Sn-Ag-Cu 솔더 접합부 금속간화합물 형성 및 성장 거동	한다경	충북대학교
	P1-18	A mathematical model analyzed how Boron Carbide filler in Ceramic/Epoxy composites affects the thermal behavior of an IC package.	ABDALLAH AL SALIM	성균관대학교
	P1-19	재배선 공정 평탄화를 위한 선택적 구리 충전 및 구리 전해연마 연구	오재환	한양대학교
	P1-20	Al ₂ O ₃ ALD layer 증착 두께에 따른 솔더 접합부 특성 평가	노은채	충북대학교
	P1-21	고주파 소자용 저온 경화형 polyimide 기반 저유전 소재 개발 및 특성 연구	남현진	한국전자기술연구원
	P1-22	Effects of Pulse Plating Parameters in FeNi Alloy Electroplating	강나영	홍익대학교
	P1-23	면광원 레이저 인터커넥션을 적용한 DPIG/Sn-3.0Ag-0.5Cu 솔더 접합부 취성파괴특성 평가	한성희	한국생산기술연구원
	P1-24	Ag 코팅 Cu 입자 함유 자체 발열 필름 소재의 소결접합 특성	이혜민	서울과학기술대학교
	P1-25	pH 조절에 의해 합성된 Cu 입자의 입도 분석 및 소결 접합 특성	김호륜	서울과학기술대학교
	P1-26	Sn-57Bi-1Ag 솔더페이스트 도포 중형비 조건에 따른 Sn-3.0Ag-0.5Cu 솔더와 접합부 특성 평가	임태윤	한국생산기술연구원
	P1-27	면광원 레이저 인터커넥션 공정을 적용한 Cu/SnAg 필러 범프 접합부의 미세조직 및 기계적 물성 연구	한상은	한국생산기술연구원
	P1-28	차세대 반도체 Ru 배선 적용을 위한 ALD ZnO 확산방지층의 공정 열처리 조건에 따른 계면접착에너지 평가 및 분석	정대윤	국립안동대학교
	P1-29	차세대 반도체 배선 적용을 위한 ALD Ru/ZnO 박막의 공정 열처리 유무에 따른 계면접착에너지 평가 및 분석	김민진	국립안동대학교
	P1-30	Interfacial reaction and drop reliability of hybrid BGA packages with different surface finished PCBs	김세환	성균관대학교
	P1-31	대기압 플라즈마로 소결된 구리-흑연 복합 시트의 접착 특성	정건주	한국생산기술연구원

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

Session	No.	Title	Author	Affiliation
2. 설계, 측정, 평가, 전산모사 기술	P2-01	FMMEA 기반 액침냉각 데이터센터의 잠재적 신뢰성 문제 식별	이중언	성균관대학교
	P2-02	새로운 샌드위치 구조의 광학적으로 투명한 접착제를 위한 폴리디메틸실록산의 기계적 물성	김도훈	한국과학기술원
	P2-03	극성 유기용매가 PEDOT:PSS 하이드로겔의 기계적 물성에 미치는 영향	강원중	한국과학기술원
	P2-04	생성형 예측 모델을 적용한 박막의 신뢰성 평가를 위한 물 표면 플랫폼에서의 데이터 추출 시스템 개발	송명	한국과학기술원
	P2-05	FCLBGA 패키지 내 Solder Ball 배열에 따른 열전달 특성 및 패키지 변형 분석	장희찬	인하대학교
	P2-06	2D 머신비전 기반 다양한 패키지 표면 불량 검사 솔루션	한기준	한성대학교
	P2-07	저전압 동작 메모리의 신뢰성 평가 방법	석주환	성균관대학교
	P2-08	파워 반도체 패키징 역공학과 고장 분석 영역에서 실리콘 젤 제거의 중요성	이규석	한국전자기술연구원
	P2-09	Analysis of Thermal and Mechanical Properties in Homogeneous and Heterogeneous Full-LTS BGA	윤재준	성균관대학교
	P2-10	하이브리드 본딩을 위한 Cu-Cu 접합 구조의 열 측정 방법론	김학준	서울대학교
	P2-11	탄소섬유 발열체의 발열특성 연구	박영주	한국생산기술연구원
	P2-12	Investigating thermal and mechanical characteristics of pogo pin: Intrusion and contact resistance analysis.	레이수안바키	서울과학기술대학교
	P2-13	나노압입시험을 통한 PI 기판에 증착된 Al, Cu 박막의 탄성계수 측정	박지현	국립안동대학교
	P2-14	유한요소해석 기반 머신러닝을 활용한 금속박막의 기계적 특성 예측	김동엽	국립안동대학교
	P2-15	전산유체역학 시뮬레이션을 이용한 솔더 페이스트 스텔실 인쇄공정 분석	김형태	부산대학교
	P2-16	레이저 파쇄 기술을 이용한 박막 계면 물성 측정	이세민	한양대학교
	P2-17	전산해석을 통한 전해동박 두께 편차의 유동 영향 평가	유강민	한국재료연구원
	P2-18	Thermal Strain Measurement of heterogeneous interfaces in Electronic Packages	이민혁	한국생산기술연구원
	P2-19	Feasibility Study of Semiconductor Packaging Interconnection Defect Detection Method Using Background Removal Technique	오찬영	한국과학기술원
	P2-20	전이학습을 이용한 에폭시 나노복합재료의 데이터 기반 멀티스케일 해석 기법	이원주	인하대학교
	P2-21	Comparative study on heat dissipation analysis according to ceramic substrate materials of SiC power module	김기철	강남대학교
	P2-22	630 ~ 850 nm 다파장 LLLT(Low level laser therapy) 광모듈의 광학적특성측정법과 신뢰성 분석	김현	전남대학교
	P2-23	태양광 인버터 수명 향상을 위한 땀납 합금 및 기판 표면 연구	이레	전남대학교
	P2-24	PI/PI 유연소자의 접착 방법에 따른 굽힘 변형률 측정	함주빈	국립안동대학교
	P2-25	에폭시 강인화제 첨가에 따른 고방열 에폭시 밀봉재의 열 및 기계적 특성 연구	정제용	한국생산기술연구원

(사)한국마이크로전자 및 패키징학회

2024년 정기학술대회 (정승부 교수님 정년기념 특별심포지엄)

Session	No.	Title	Author	Affiliation
3. 첨단 패키징 기술	P3-01	스마트워치용 밴드에 내재가 가능한 유연한 메모리 제품 개발	이혁	호서대학교
	P3-02	레이저 전사 접합을 적용한 Cu/Sn-1.8Ag 미세범프의 전류 및 열사이클 복합하중에 따른 계면 반응 분석	권용범	국립안동대학교
	P3-03	Investigation of electrochemical migration behavior of various surface treatment	강동길	성균관대학교
	P3-04	하이브리드 본딩에서 Cu-Cu bonding 을 위한 분석적 접근	이시예	서울과학기술대학교
	P3-05	Advanced interconnections of aluminum and copper flexible printed circuit boards for battery management systems using regional and transient laser-assisted soldering	김서아	한국생산기술연구원
	P3-06	Optimization of hybrid bonding process conditions through numerical analysis	레이수안바익	서울과학기술대학교
	P3-07	A comprehensive study of preventing crack formation in 2.5D glass interposer	레이수안바익	서울과학기술대학교
	P3-08	전력반도체의 고강도 접합을 위한 무가압 은 나노 페이스트 소결 기술	구모세	서울과학기술대학교
	P3-09	저온 솔더링 적용을 위한 갈륨과 다층구조 UBM 간의 계면반응 연구	심윤섭	조선대학교
	P3-10	고온 장기 시효에 따른 Sn-2.3Ag flip-chip solder bump 접합부의 금속학적 반응 및 기계적 특성 평가	장은수	충북대학교
	P3-11	유리관통전극 (TGV) 을 위한 선택적 구리 전극 증착 방법	YANG FAN	한양대학교
	P3-12	광펄스 솔더링을 이용한 Sn-58Bi 무연솔더 접합공정 연구	고혜리	조선대학교
	P3-13	MXene 나노입자를 포함하는 무연복합솔더 개발에 관한 연구 (A study on the development of lead-free composite solder containing MXene nanoparticles)	김민형	조선대학교
	P3-14	DAF-less Chip Stacking PKG using Self-Assembled Monolayer	김원빈	서울대학교
	P3-15	전사 인쇄를 활용한 다종의 박막 반도체 이중 집적 3D IC 기술	홍성우	한양대학교
	P3-16	주석과 니켈 적층 금속 프리폼을 이용한 천이액상확산 접합	이동복	충북대학교
	P3-17	팬아웃 패키징 재배선 적용을 위한 PI 절연층의 온도에 따른 박막 응력 평가 및 분석	김범기	국립안동대학교
	P3-18	Self-Assembled Monolayers (SAMs)을 이용한 Cu-Cu 접합	김용석	충남대학교
	P3-19	Direct deposition of silver in through glass via hole by inkjet printing	Hamza Hussain	성균관대학교
4. 마이크로 전자부품 기술	P4-01	동시전사접합기술 기술을 이용한 마이크로 발광다이오드의 전사, 접합, 그리고 수리	신정호	한국전자통신연구원
	P4-02	건전성 예측관리기술 소개 및 연구동향: Electronics 분야	김대환	성균관대학교
	P4-03	저차원 유무기 복합 페로브스카이트 박막 제조 및 분석	이세영	충남대학교
	P4-04	3D Transfer printing technology using shape deformable PVA-based stamp	양현지	한양대학교
	P4-05	Permittivity Change of Dielectro-elastic Composite with Stretchable and stretch-Unresponsive Wireless Electronics	최건오	한양대학교
	P4-06	Self-recoverable, elastic electrospun thermoplastic polyurethane integrated with fluorinated ethylene propylene for applying triboelectric nanogenerator	트란 독 칸	성균관대학교
	P4-07	Development of Self-Healing Triboelectric-Based Pressure Sensor with Contact Time Responsiveness	최수빈	성균관대학교
	P4-08	Ni-Mn-Co 기반 NTC온도센서의 AI 도핑에 따른 구조 분석 및 특성평가	전하윤	경기대학교